

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2023 年 06 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	06 月 15 日 16:00-17:00 北京和聚投资、上海雅策投资、华泰证券、Pinpiont、富瑞证券、Janus Henderson、富达基金 06 月 30 日 15:00-16:00 Polunin、Greenwoods、Invesco、Winsoul Capital、TF International Securities、Spruce Light Asset Management、军舰鸟私募证券投资基金、华贵私募投资基金、上海民拓富邦私募基金、国联证券、苏州吴越资本、苏州乾丞基金、无锡融金投资基金、宜兴市锦城建设、国联通宝、Matthews Asia、Capital (Shanghai) Business Management、Macquarie
时间	06 月 15 日 16:00-17:00 06 月 30 日 15:00-16:00
地点	无锡
上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子投资者关系高级经理

投资者关系活动 主要内容介绍	问题一：请问公司如何展望下半年终端应用市场的景气度？ 答：从下游应用来看，消费电子行业需求仍然非常疲软，新能源、电动汽车等新兴领域的市场空间较大。目前还处于行业周期的底部。 问题二：请问公司目前的产能利用率有多少？ 答：公司目前 6 吋、8 吋晶圆制造产能是满载状态；重庆 12 吋处于产能爬坡阶段。 请问三：请问公司目前产能有多少？ 答：公司有 3 条 6 吋线，月产能 23 万片；2 条 8 吋线，月产能 14 万片；2 条 12 吋线，1 条生产通线，月规划产能 3 万片，1 条启动建设，月规划产能 4 万片。 问题四：请问公司在汽车领域的产品布局有哪些？ 答：公司 2022 年召开了车规级产品发布会，发布沟槽栅 MOS、SJ MOS、IGBT、SiC MOS 等系列化车规级产品及模块产品，已向头部整车厂商及汽车零部件 Tier1 供应商进行供货。 问题五：请问公司如何展望后期毛利率？ 答：目前消费类等终端未见明显复苏，且仍受到行业周期的影响，毛利率将面临一定挑战。 问题六：请问公司下游终端应用上有哪些调整和布局？ 答：公司不断调整产线资源结构、产品结构、市场结构和客户结构，积极布局潜力赛道，汽车电子、新能源、工控通信等应用领域占比不断提升，达到 70%。 问题七：请问公司 IGBT 2023 年目标及增长动能有哪些？ 答：2023 年公司 IGBT 产品营收的目标是 10 亿元，增长动能方面，一是来源于晶圆制造工艺的升级，公司 IGBT 产品从 6 吋产线升级到 8 吋产线，未来逐步会升级到 12 吋产线；二是 IGBT 的产能根据规划目标做了扩充；三是建立模块封装产线；四是公司 IGBT 产品下游终端应用结构不断优化，工控和汽车
---------------------------	---

	电子占比 85%，市场空间大。 问题八：请问公司 IGBT 产品的优势有哪些？ 答：一是公司 IDM 商业模式，供应链可控；二是 IGBT 产品与 FRD 均为自有产品，可相互配套；三是公司 IGBT 产品性能在国内处于领先地位。 问题九：请问公司碳化硅产品目前进展及预期规划？ 答：公司碳化硅二极管市场拓展基础上，持续完善产品型谱；进一步加大 SiC MOSFET 工艺技术能力建设和产品设计开发，推进 SiC MOSFET 产品规模上量，并向汽车电子、光伏、储能等高端市场进行推广。 问题十：请问公司超结 MOS 目前进展及未来规划？ 答：公司积极推动高压超结 MOSFET 平台开发及产品系列化丰富，2022 年同比增长 166%，同时在 MOSFET 产品中的占比不断提升。公司未来将逐步扩大 8 吋和 12 吋超结 MOS 的产能规模，2023 年超结 MOS 预计也会保持较高增速。 问题十一：请问公司模块产品有哪些？目前进展如何？ 答：公司模块产品包含 TMBS 模块、IPM 模块、MOS 模块、IGBT 模块四大类，2023 年将会实现较快增长。 问题十二：请问公司在传感器方面的布局？ 答：公司将拓展 8 英寸 MEMS 产品并研发新一代高性能压力和温湿度传感器，光电传感器深耕电源、工业仪表细分市场。同时公司将利用现有的制造资源 and 能力，加大对外投资，加强公司在自主传感器产品的布局。 问题十三：请问公司在智能控制方面的布局？ 答：公司智能控制产品包括驱动及 MCU 等产品，2022 年增长超过 10%，公司安全 MCU 产品完成芯片流片，将在汽车电子、物联网、工业互联网方面实现销售。 问题十四：请问公司目前封装的产能情况及后期规划？
--	--

	答：公司目前封装能力月产能 8.7 亿颗。未来将通过重庆封测基地项目为抓手，全面覆盖功率半导体产品模块封装、晶圆中道生产线、面板级封装、第三代半导体封装等技术领先门类，有序推进封装工艺升级。 问题十五：请问第三代半导体目前发展及后期规划？ 答：公司碳化硅和氮化镓均已实现量产， SiC MOS 第一代平面型 MOS 器件性能国内领先，同时已启动开发第二代沟槽型 MOS 结构。2023 年碳化硅和氮化镓产品营收力争规模上亿元平台。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 06 月